

## シールドソフトパッキング

### Flame-retardant Shield Soft Packing

SSP-N series



## 用途

## Applications

- 筐体のグラウンディング & シールドリング。
- I/O パネル部のシールドリング。
- D-sub コネクタのシールドリング。
- パソコン、ノートパソコン、スマートデバイス、カーナビ等のシールドリング。

※使用上の注意として、両面を圧接取り付けするだけの使用として下さい。

Chassis grounding and shielding.  
Shielding of I/O panels.  
Shielding of D-sub connectors.  
Shielding of desktop computers, laptops, smart device, and car navigation systems.  
\* Fit the gasket simply by pressing on both sides.

## 品番表

## Product list

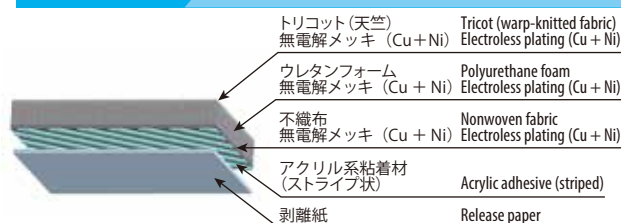
[単位 Unit:mm]

品番 Product code	厚み Thickness	有効サイズ Effective size	
		幅 Width	長さ Length
SSP-010N	1.35±0.4	290±5	490±5
SSP-020N	2.00±0.4	290±5	490±5
SSP-030N	3.05±0.4	290±5	490±5

※ご希望の形状による切断、打ち抜き、ハーフカット加工品での納入となります。  
\* Gaskets are cut off, die-cut, or kiss-cut into the desired shape before shipment.

## 構造

## Structure



## 特長

## Features

- ウレタンフォームの連泡孔からベースの不織布及び上面トリコット（天竺）まで無電解メッキがされているので非常に高いシールド特性を発揮します。
- ベース裏面の粘着剤がストライプ状に加工されているので導通損失がありません。
- 圧縮して使用すると最良のシールド効果が得られます。筐体の合わせ目、ハウジングの合わせ目のシールドリングに最適です。
- 任意の形状に切断、打抜き、ハーフカットの加工が容易にできます。

The SSP-N series provides effective shielding due to an electroless plating applied to the open cells of polyurethane foam, a nonwoven base fabric, and tricot (warp-knitted fabric) on the top.

The adhesive on the rear of the base fabric is applied in a striped pattern to prevent conduction losses.

Shielding effects are maximized when the gasket is compressed. The gasket is ideal for shielding joints in a chassis or housing.

Gaskets are easily cut off, die-cut, or kiss-cut into various desired shapes.

## シールド効果

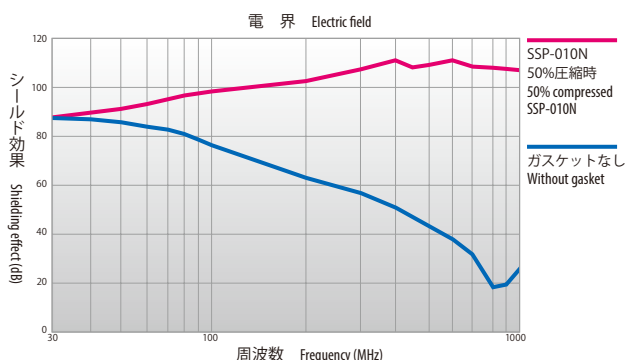
## Shielding effect

[測定方法]

50mm×70mm の開口部外周に試験サンプル（高さ 1mm/ 幅 10mm）を貼り付け、サンプル高さ 50%圧縮で開口部に蓋をする。その際、試験サンプル（0.5mm の隙間）から漏れる電磁波を KEC 法で測定し、試験サンプルを取り付けない場合と効果を比較する。

[Measurement method]

Attach a test sample (1 mm high and 10 mm wide) around the outside edge of a 50 mm x 70 mm opening. Compress the sample until the height is reduced 50% and place the lid over the opening. Measure electromagnetic waves leaking from the test sample (through the 0.5 mm space) by the KEC method. Compare measurement results with and without the test sample.



本データは、KEC 法で測定した結果です。  
The above data are measurements made by the KEC method.

## 一般特性

## General characteristics

項目 Item	条件 Conditions	SSP-010N	SSP-020N	SSP-030N
使用温度範囲 Operating temperature range		-20℃～70℃	-20℃ to 70℃	
表面抵抗率 Surface resistivity		0.3Ω/□以下	0.3Ω/□ or less	
粘着力 Adhesive strength	180°ピール：貼付 24 時間後 180°Peel test after 24 hours	5N/25mm 以上	5N/25mm or more	
接触抵抗値 Contact resistance	10mm×50mm,50% 圧縮 10mm×50mm,50%compression	0.01Ω	0.05Ω	0.11Ω

(注) この数値は実測値で保証値ではありません。  
\* The values are not guaranteed.